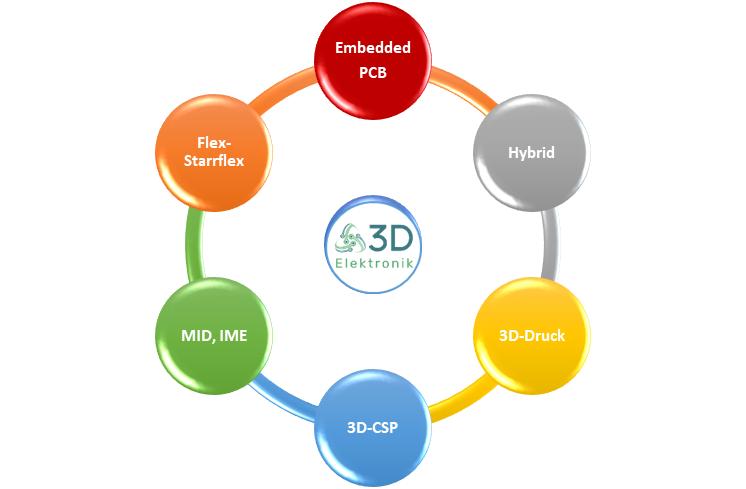
**Bilder**

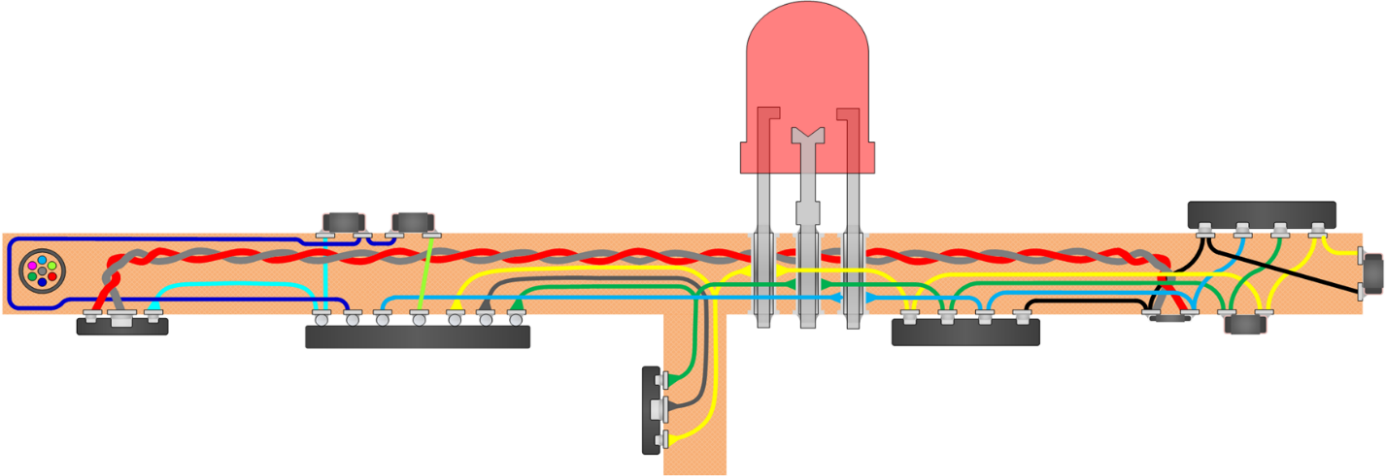


Bildunterschrift: Zur 3D-Integration in der Elektronik stehen unterschiedliche neue AVT-Technologien   
 zur Verfügung (Quelle: Jöckel Innovation Consulting)



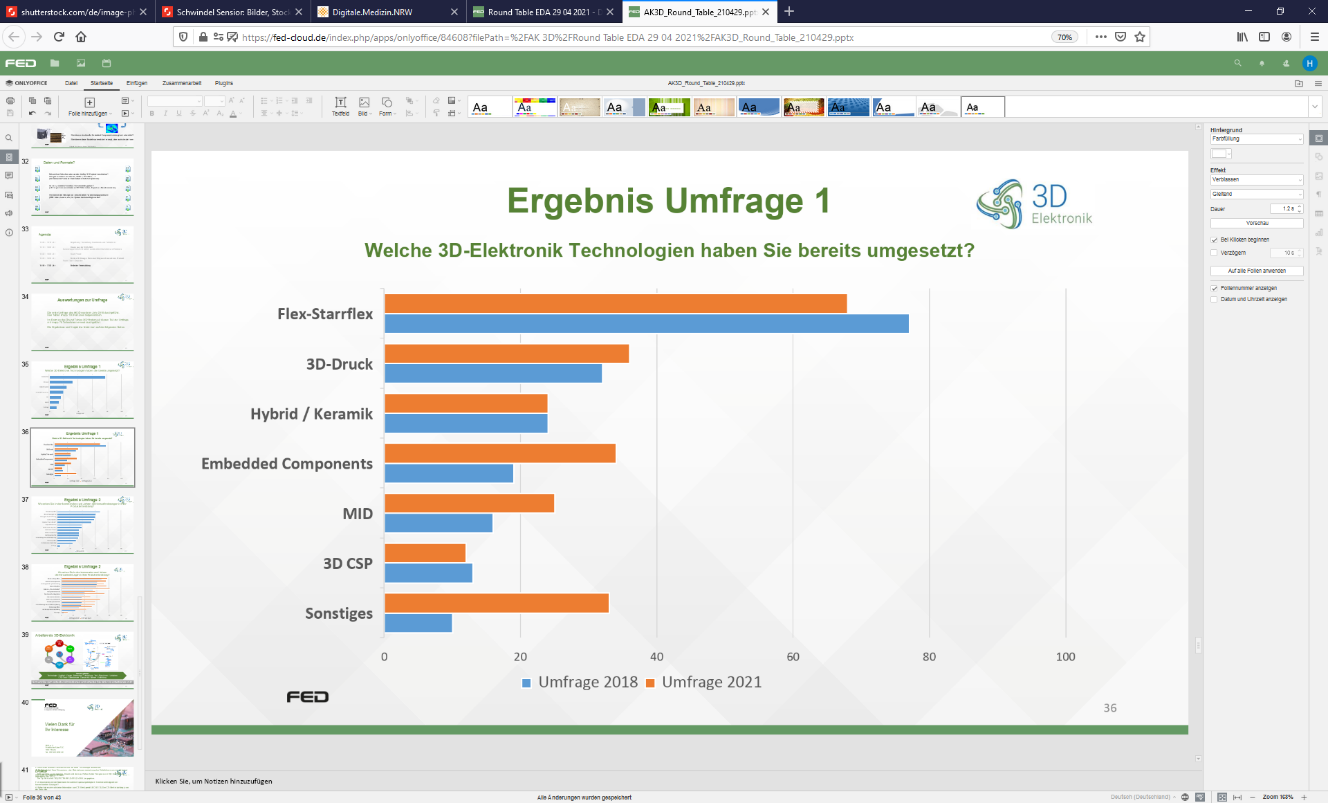
© GEDmbH

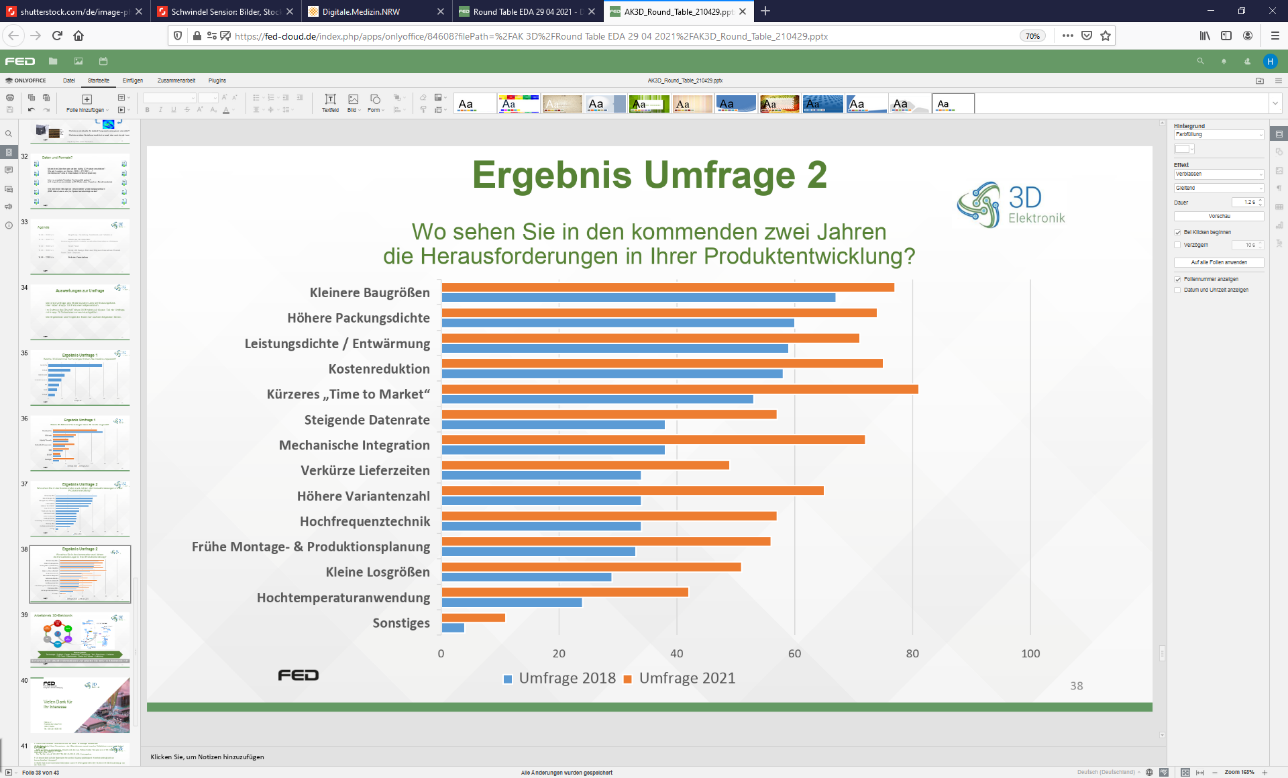
Bildunterschrift: Sensorgehäuse mit USB-Stecker, kapazitiver Sensor, LED, Antenne hergestellt im 3D-Multimaterialdruck (Quelle: GEDmbH)



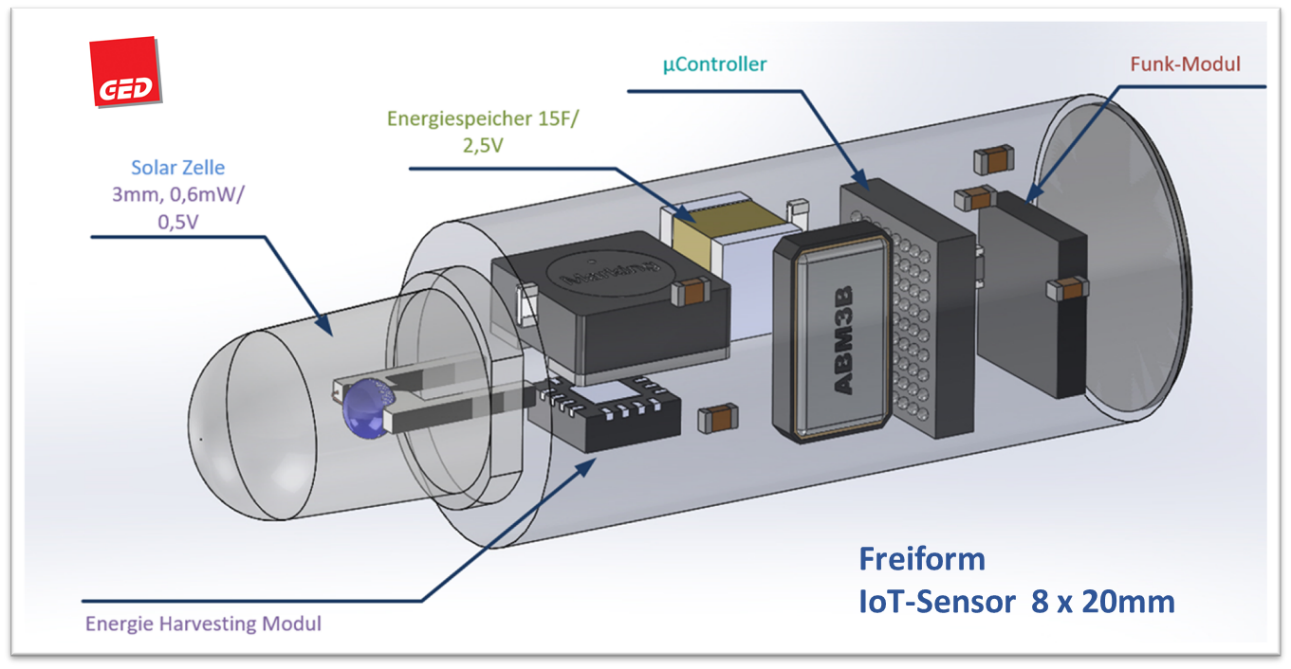
© Semikron

Bildunterschrift: 3D-Elektronik benötigt individuelle eCAD-Software-Funktionalität





Bildunterschrift: Die Umfrage innerhalb des Round Tables zeigt deutlich, dass die Tendenz für 3D-Elektronik in den letzten 3 Jahren erheblich zugenommen hat. (Quelle: FED e.V.)



Bildunterschrift: IoT-Multisensor“ inklusive BLE-Antenne und Energy-Harvesting mit einer Baugröße von nur 8 x 20 mm (Quelle: GEDmbH)



Bildunterschrift: Logo zum 3D-Elektronik-Netzwerks (Quelle: Jöckel Innovation Consulting)